



HICC

天堂之芯

国家“芯火”双创基地（平台）
国家集成电路设计杭州产业化基地|孵化器
浙江省集成电路设计公共技术平台

2019 年第 8 期 （总第 319 期） 2019.8.30 www.hicc.org.cn

■本地要闻

- ▲ 中国研究生创芯大赛圆满收官
- ▲ 滨江向“芯”产业进发 争创全省首个芯片设计与测试产业创新服务综合体
- ▲ 杭州集成电路产业园正式启动！华澜微等四大项目签约落户
- ▲ 士兰微斥资 15 亿元扩充 8 吋线产能 芯片产品迈向高端
- ▲ 以闪存加速数字经济，2019 全球闪存峰会在杭州举行
- ▲ 中晶（嘉兴）半导体大硅片项目明年底试生产
- ▲ 浙江省龙芯智慧产业园落地金华

■业界动态

- ▲ 深圳集成电路再看坪山，重磅 IC 基地落地
- ▲ 苏州高新区欲打造国家级集成电路公共服务平台
- ▲ 北京顺义出台支持政策 促进第三代半导体产业聚集
- ▲ 武汉：集聚百余家芯片企业，筹划 10 亿元光谷集成电路产业基金

- ▲ 芯思想研究院推出第一版中国集成电路产业规模城市排名榜
- ▲ 合肥兑换集成电路产业红包，年销售首次破百亿奖励五百万元
- ▲ 集成电路、生命健康产业增长迅猛 南京江北新区崛起两大千亿级产业集群

■ 通知公告

- ▲ 浙江省科学技术厅国家税务总局浙江省税务局关于印发《进一步落实税收优惠政策服务科技创新发展的若干措施》的通知
- ▲ 滨江区关于开展杭州市 **2019** 年“百千万”高技能领军人才遴选工作的通知

本地要闻

中国研究生创芯大赛圆满收官

8月4日上午，50支进入答辩环节的队伍正在进行紧张的答辩，以决出最后进入路演环节的15支队伍。

另一边，白马湖二楼的宴会厅内大咖云集，在“用‘芯’为祖国点赞”高峰论坛中共同研讨集成电路产业发展大计和趋势，展望集成电路生态和产业化的美好前景。

论坛由中国研究生电子设计竞赛发起人、原清华大学教授周祖成的致辞开启。

杭州高新区管委会主任、滨江区区长李志龙出席论坛并致辞。



△杭州高新区管委会主任、滨江区区长李志龙

论坛邀请到了包括国家示范性微电子学院建设专家组组长严晓浪、中芯国际首席执行官赵海军、新思科技全球副总裁葛群、澳门大学 AMSV 国家重点实验室副主任余成斌、华山资本创始合伙人兼董事长陈大同、华为海思上海研究所分部部长郑军、北京华大九天软件有限公司董事长刘伟平、龙芯 CPU 首席科学家胡伟武、Cadence 全球 AI 研发中心高级 AI 研发总监丁渭滨等重量级嘉宾进行主题分享。



△国家示范性微电子学院建设专家组组长严晓浪



△现场图

经过激烈角逐和路演环节，最后获得创芯之星的队伍是：

- 上海交通大学 E-Artists
- 西安电子科技大学 IC有、难
- 上海交通大学 热血篮球

由中国工程院院士、中国研究生创“芯”大赛组委会名誉主任倪光南老师和中国科学院院士、中国研究生创“芯”大赛专委会名誉主任陆建华老师为获奖队伍颁奖。



△陆建华老师为获奖队伍颁奖



△倪光南老师为获奖团队颁奖



△詹敏书记为获奖团队颁奖



△大赛一等奖获奖者合影

学校名称	队伍名称
上海交通大学	这就是芯片
西安电子科技大学	IC有、难
浙江大学	604小分队
东南大学	Revenge Spear
华东师范大学	ECNU魔镜队
浙江大学	eda小分队
中国科学院大学	我们的代码没有bug
上海交通大学	E-Artists
复旦大学	芯芯火炬
浙江大学	hwSec
电子科技大学	沙河IGBT小分队
浙江大学	浙江大学ICLAB干活不累队
上海交通大学	热血篮球
上海交通大学	放完风筝再流片
西安电子科技大学	Doctors

学校名称	队伍名称
电子科技大学	达立缘
上海交通大学	大侦探皮尔摩斯
上海交通大学	华盖守护神
华中科技大学	华中科技大学做了一点小事队
西安电子科技大学	芯原力
华中科技大学	GEMS创芯小组
西安电子科技大学	大碗宽面QAQ
西安电子科技大学	绿芯Team
复旦大学	逸夫楼小分队
电子科技大学	圣斗士芯使
西安电子科技大学	芯缘译码
上海交通大学	流完片放风筝队
华东师范大学	开拓者
西安电子科技大学	脑芯舒
西安交通大学	芯使命
西安电子科技大学	长安芯
西安电子科技大学	对对对
西安电子科技大学	三脚猫
西安电子科技大学	bleep bloop
深圳大学	眼镜队
浙江大学	deepzz
西安电子科技大学	十万伏特
西安电子科技大学	超烂番茄
华东师范大学	权游烂尾
上海交通大学	点子王 2.0
电子科技大学	视野
重庆大学	芯欣向荣
西安交通大学	深藏功与名
福州大学	欲”芯“千里目
中国科学院大学	高铁很晃
东南大学	lzl队
上海交通大学	TripleCarriers
浙江大学	创芯搭档
西安电子科技大学	芯起点
华中科技大学	有源负载差动队

△大赛一等奖和二等奖获奖名单

另外，大赛还颁布了9个优秀组织奖和18个优秀指导教师奖，表彰在比赛期间有突出贡献的学校和教师；另有多项企业赞助奖，颁布给做出了优秀企业项目的队伍。

晚上，大赛组委会为同学们准备了精彩的晚宴，有青春洋溢的舞蹈表演、舒缓的民谣歌曲和大量豪华抽奖礼品。



△晚宴

正如最后颁特等奖奖品时华为杭州研究所招聘调配部部长朱加峰所说，目前中国的微电子行业还有很大的进步空间，而参赛的各位都是微电子学院中的佼佼者，是行业的未来。

祝愿各位同学前程似锦，一“芯”一意，做最耀眼的“芯”！

大赛承办方：

杭州国家“芯火”双创基地

2018年3月，国家工信部批复依托杭州国家集成电路设计产业化基地建设“芯火”双创基地（平台），从而成为全国第五家国家“芯火”平台。杭州国家“芯火”平台在原有浙江省集成电路设计公共技术平台的基础上，进一步提升技术服务和产业孵化能力，建成立足杭州、覆盖浙江、辐射周边的集成电路产业创新创业服务平台。

平台建设有公共EDA服务平台、IP应用服务平台、MPW服务平台、验证与测试服务平台、人才培养及孵化平台等。

平台先后培育了杭州国芯、矽力杰、万高科技、杭州中天微等一批在国内技术创新处于领先地位的明星企业。

滨江向“芯”产业进发 争创全省首个芯片设计与测试产业创新服务综合体

一直以来，信息产业是我区的主导产业。在细分领域，芯片技术是其中最“高精尖”的部分。近日，我区正式提出争创浙江省芯片设计与测试产业创新服务综合体的目标，打造以产业创新公共服务平台为基础，政企学共同参与，促进产业发展的新型载体。据悉，这将成为全省首个以芯片设计与测试产业为主导的创新服务综合体。

打造完整的全“芯”产业链

争创省级芯片设计与测试产业创新服务综合体，我区已具备良好的产业优势。

作为高新区，我区集成电路产业起步较早，是国家最早批准的7个国家级集成电路设计产业化基地之一，也是全国第5个“芯火”双创基地，设计研发能力和产业集群双提升，走在全国前列。2018年，我区集成电路设计产业实现营业收入突破60亿元，产业规模占杭州全市的比重达到80%。在集成电路的核心——芯片技术上，从芯片设计到测试，滨江已经打造出一条拥有自主创新知识产权的全“芯”产业链。

联芸科技是我区一家芯片设计企业。目前，联芸科技在控制芯片的领域，打破了之前国外厂商的垄断，与美国美满科技、台湾慧荣科技一起成为全球最为领先的三大SSD控制芯片厂商。在芯片制造上下游的对接上，我区可以无缝连接。

芯片和别的产品不一样，不是人眼就能看出产品好还是不好，需要精密的仪器去校对每一个数据，根据数据评估性能。长川科技就是在这一环节做到了中国领先。自主研发的测试机、分选机、探针台等产品核心性能指标比肩国际一流水平。

另外，中天微和士兰微、国芯科技、澜起科技（杭州）、朔天科技、万高科技、微纳科技等多家杭州市本地集成电路企业也已达成了良好互动，双方合作的芯片产品累计产销已达2亿颗。在信息经济领域，阿里巴巴、海康威视、新华三等知名企业在优势领域中对国产化芯片行业应用推广，为本地乃至国产芯片产业发展提供了广阔的市场空间。可以说，我区在芯片设计与测试产业已经具备了先发优势。

搭建高能级的公共服务平台

派恩杰半导体（杭州）有限公司是第一批入驻杭州国家“芯火”双创基地的企业之一，企业以生产碳化硅和氮化镓的功率器件为主，经过半年多的发展，该公司就已

完成全球第一款可兼容驱动 650V 氮化镓功率器件，产品广泛应用于新能源汽车、5G 物联网等场景和领域。公司运营总监陈然介绍，公司决定将项目在“芯火”落地，主要基于滨江芯片产业的聚集效应。“在这里，不仅有更多产品上下游的合作空间，而且能享受到更好的公共服务。”

派恩杰所在的杭州国家“芯火”双创基地已构建了公共 EDA 服务平台、IP 应用服务平台、MPW 服务平台、验证与测试服务平台、人才培训及孵化平台等专业化公共服务平台。这些公共服务平台会带给企业专业化的帮助。陈然说：“例如 EDA 服务平台，

我们只要花费少量费用就可以使用专业化的软件进行产品的研发升级，这大大降低了我们成本。”除了“芯火”双创基地，我区还拥有国家级集成电路人才培养基地、杭州国家集成电路设计企业孵化器重量级孵化机构，围绕企业研发设计、人才培养、创业孵化、科技成果转化开展专业化服务。

好马配好鞍。为了鼓励企业发展，我区密集出台了“新 11 条”“1+X”“黄金 12 条”“5050 计划”等政策措施，有力促进集成电路产业向高、精、尖方向发展，全力打造国内一流的创新创业环境。

培育有影响力的产业集群

在争创综合体的道路上，我区目标很明确，就是要整合现有平台资源，发挥企业技术优势、提升创新创造能力，推动培育形成具有全国影响力的集成电路设计与测试产业集群。具体来说，就是提升产业发展质量、增强产业创新能力、壮大骨干企业队伍、优化创新服务环境。力争到 2021 年末，我区集成电路设计与测试产业集群营收突破百亿元、集群企业数达 120 家。

“争创全省首个芯片设计与测试产业创新服务综合体归根到底还是要进一步提升对企业的精准服务水平，打造公共服务和专业技术支撑平台，加强产业集聚，推动产业发展。”杭州国家“芯火”双创基地相关负责人介绍。

在综合体的创建中，我区采用“一核多点”的建设模式。“一核”指的是，以海创基地为核心，全面整合杭州国家集成电路设计产业化基地、杭州国家“芯火”双创基地现有的优势资源和专业技术平台以及海创基地的产业孵化培育全程式支撑体系。“多点”主要包括天堂软件园、滨江互联网产业园、滨江物联网产业园等涉及集成电路细分领域的产业园区，依托各类产业园，引进培育各类集成电路企业。

（来源：天堂硅谷报）

杭州集成电路产业园正式启动！华澜微等四大项目签约落户

在 8 月 22 日举行的 2019 全球闪存峰会上，杭州集成电路产业园正式启动！

据了解，杭州集成电路产业园是在国家工信部信软司和浙江省经信厅的指导下，在杭州市人民政府的大力支持下成立，是杭州市重点打造的首个集成电路集聚园区。该产业园规划建筑体量为 100 万平方，首期 15 万平方，位于萧山经开区信息港小镇。

园区主要包括国产集成电路芯片设计，电脑硬盘，大数据磁盘阵列三大产业，同时将重点引入国家省市重点企业研究院，实验室及高校产学研研究中心。目前已经集聚了包括华澜微，鼎龙控股，钜联半导体在内的相关产业龙头企业。

据透露，园区成功运营后，年产值将突破百亿，税收突破十亿，将有力支撑萧山区经济的快速发展。

此外，在会议上还举行了杭州（萧山）集成电路重大投资项目签约仪式，签约了华澜微云存储系统高端控制芯片项目，鼎龙集成电路芯片项目，钜联半导体充电桩芯片项目，宝嵩机器人研发中心及智能柔性化工作站项目。

其中，华澜微云存储系统高端控制芯片项目由华澜微拟投入 2000 万美元，研发用于大数据，云存储系统的高端控制芯片，硬盘阵列，以实现进口替代。该项目得到了 IBM 的大力支持，预计经济效益将达到 20 亿美元。

鼎龙集成电路芯片项目总投资 15 亿元，涵盖芯片设计，半导体材料等内容。钜联半导体充电桩芯片项目总投资 1 亿元。宝嵩机器人研发中心及智能柔性化工作站项目总投资 1.8 亿元。

（来源：集微网）

士兰微斥资 15 亿元扩充 8 吋线产能 芯片产品迈向高端

8 月 27 日晚间，士兰微(600460)披露 2019 年半年报。透过这份定期报告，可以看到士兰微的芯片产品，正在从低端向高端蜕变。同日，士兰微公告显示，该上市公司拟斥资 15 亿元，正式启动士兰集昕二期项目，扩充 8 吋线产能。

芯片产品向高端迈进

上半年，随着士兰微各类电路新产品的出货量明显加快，旗下集成电路的营业收入为 4.91 亿元，较去年同期增长 1.7%。预计下半年，士兰微集成电路的营业收入增速还将进一步提高。

目前，国内从事半导体的企业，产品主要聚焦在量大面广的中低端消费品上，客户的门槛总体不高，这就造成了半导体企业在中低端的产品上竞争激烈。而相对于竞争激烈的中低端消费类产品，可以提供应用于白电、通讯和汽车等领域的芯片企业，在国内却少之又少。

为此，加快芯片产品进入高门槛行业，成为国内半导体产业升级方向。所以，近年来士兰微发力的方向，基本上就是沿着高端芯片领域布局。

而从 2019 年半年报来看，士兰微此前的付出已看到成效，旗下 IPM 功率模块产品在国内白色家电（主要是空、冰、洗）、工业变频器等市场继续发力。2019 年上半年，国内多家主流的白电整机厂商在变频空调等白电整机上使用了超过 300 万颗士兰 IPM 模块，预期今后几年将会继续快速成长。

2019 年上半年，士兰微基于自主研发的芯片、算法以及系统，其空调变频电控系统在国内空调厂家完成了几千台变频空调的上量试产，性能优异、质量稳定；全部芯片自主研发的电动汽车主电机驱动模块完成研发，参数性能指标先进，已交付客户测试；士兰微开发的针对智能手机的快充芯片组，以及针对旅充、移动电源和车充的多协议快充解决方案的系列产品，已开始在国内手机品牌厂商进行产品导入；公司开发的针对智能手机的快充芯片组，以及针对旅充、移动电源和车充的多协议快充解决方案的系列产品，已开始在国内手机品牌厂商进行产品导入。

分立器件成品是士兰微当年营收主力，上市公司上半年分立器件成品的出货量继续保持较高增长，产品的营业收入为 6.79 亿元，较去年同期增长 3.36%。预计下半年公司分立器件成品的销售将继续保持较快增长。

具体来看，上半年，子公司士兰集成总计产出芯片 106.54 万片，比去年同期减少 7.41%，减少的原因是部分客户订单数量减少导致产能利用率下降所致；目前，士兰集成已开始进行针对“汽车级功率模块产品”的小批量产能扩充，为下一阶段汽车级功率模块厂的建设进行人员和产品储备。

另外，子公司士兰集昕总计产出芯片 17.6 万片，比去年同期增加 74.25%。上半年，士兰集昕加快了特色工艺平台建设进度。0.25 微米的 BCD 电路工艺平台和 0.18 微米的 BCD 电路工艺平台已相继建成，并开始实现小批量产出。

半年报显示，士兰集昕已有高压集成电路、高压超结 MOS 管、高密度低压沟槽栅 MOS 管、TRENCH 肖特基管、大功率 IGBT 等多个产品导入量产，产品结构调整步伐明显加快。2019 年下半年，士兰集昕将进一步加大对生产线投入，提高芯片产出能力。

斥资 15 亿元扩充 8 吋线产能

8 月 27 日晚间，士兰微还发布公告披露，将正式启动士兰集昕二期项目。

士兰集昕 8 吋线于 2017 年 6 月底正式投产，产出逐步增加，2018 年总计产出芯片 29.86 万片。8 吋线持续上量对士兰微的整体营收增长起了积极推动作用。为进一步提高芯片产出能力，提升制造工艺水平，士兰集昕拟对 8 吋线进行技术改造。

该项目利用士兰集昕现有的公用设施，在现有生产线的基础上，通过增加生产设备及配套设备设施，形成新增年产 43.2 万片 8 英寸芯片制造能力。据悉，项目总投资 15 亿元，建设周期约为五年，分两期进行。其中，一期计划投资 6 亿元，形成年产 18 万片 8 英寸芯片的产能；二期计划投资 9 亿元，形成年产 25.2 万片 8 英寸芯片的产能。

士兰集昕此次拟新增注册资本 7.03 亿元，上市公司和国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称大基金）此次拟以货币方式，共同出资 8 亿元，认购士兰集昕新增的全部注册资本。其中，士兰微出资 3 亿元，大基金出资 5 亿元。

士兰微认为，如此次投资事项顺利实施，将有效调整公司的资产结构，为公司 8 吋集成电路芯片生产线的后续建设提供重要的资金保障，有利于加快公司 8 吋线的建设和运营，从而进一步提升公司制造工艺水平，增强公司盈利能力，提高综合竞争力。

（来源：证券时报·e 公司）

以闪存加速数字经济，2019 全球闪存峰会在杭州举行



8月22日，由浙江省经济和信息化厅、杭州市人民政府指导，杭州市萧山区人民政府主办，萧山经济技术开发区管理委员会、中国计算机学会信息存储专委会、武汉光电国家研究中心协办，北京世纪百易网络有限公司（DOIT）、杭州华澜微电子股份有限公司承办的“2019全球闪存峰会”在杭州国际博览中心（G20主会场）盛大举行。



△ “2019全球闪存峰会”会场

浙江省政协副主席周国辉，中国科学院院士朱诗尧，中国工程院院士潘德炉，工信部信软司两化融合推进处副调研员梅扬，浙江省经信厅总工程师厉敏，杭州市副市长柯吉欣，杭州市经信局党组书记、局长夏积亮，杭州市科技局党组书记、局长邵立春，萧山区区委副书记、区长王敏，浙江省半导体行业协会秘书长陈光磊，萧山区委常委、开发区党工委书记、管委会主任叶建宏，萧山区副区长魏大庆、开发区党工委委员、管委会副主任钟华成，来刚，浙江省委网信办信息化协调处处长王天媵等领导出席会议开幕式；参加峰会的还有浪潮、华为、华澜微、阿里云、宝存科技、大普微、国科微，英特尔、戴尔科技集团、IBM、三星、东芝、SK海力士、新华三、西部数据、联想凌拓、Memblaze、PureStorage 和威固等国内外科技领域的领导企业代表。本次峰会共吸引了约 3000 名各界代表以及来自全国媒体近 100 家媒体参加。



△ “2019 全球闪存峰会”会场



△浙江省政协副主席周国辉致开幕词

浙江省政协副主席周国辉在致词中表示，杭州不仅拥有非常好的互联网、大数据方面的产业基础以及优秀的人才、金融等要素集成的互联网创业创新生态，而且集聚了数据存储产业集群；峰会在萧山的召开，意味着杭州存储产业已具备一定实力，展示了一个城市产业发展的方向、趋势和雄心壮志。他期盼今天的大会能够成为在浙江省数字经济以及城市产业发展的里程碑。



△中国工程院院士潘德炉发表主题演讲

中国工程院院士潘德炉在主题演讲中指出，第四次产业革命是信息与物理融合的技术，是人类进入智能化的时代；信息的智能技术已经成为渗透到经济、社会和生活

的先导技术。他认为，数据智能是智慧海洋建设的核心之核心技术，而顶层设计研发、存储器产业生态环境建立、政府统筹和企业广泛参与，则是我国数据智能和闪存高速技术发展之路。



△工信部信软司两化融合处副调研员梅扬致辞

工信部信软司两化融合处副调研员梅扬表示，随着新一代信息技术不断地扩散和深度应用，数据的采集、存储、分析、共享、应用、服务增值将产生巨大的需求，企业级、工业级存储产品的研发和应用将不断创新，也将催生一系列的新产品模式和业态，推动各行业加速向网络化、数字化、智能化变革，为我国经济提供新的发展动能。

发展数字经济，数据是基础，存储是基石。数据的存储与创新是互联网、大数据、人工智能等行业发展的基石，是新一代信息技术发展的重要方向。2018年，全球企业级存储市场规模超过270多亿美元，而中国仅占12%，市场潜力巨大。

本次峰会的成功举办
将为加速浙江“一号工程”实施
促进闪存和存储产业发展
增进全球上下游产业链之间的紧密合作和互动交流
加速产业生态链建设
让世界更加了解中国、了解浙江
让中国更多了解和融入全球闪存产业生态

“杭州集成电路设计产业园”隆重启动



△浙江省政协副主席周国辉，中国科学院院士朱诗尧等领导、专家和嘉宾出席“杭州集成电路设计产业园”启动仪式。



此次揭牌的杭州集成电路设计产业园位于萧山经开区信息港小镇，是在国家工信部信软司和浙江省经信厅的指导下，杭州重点打造的首个集成电路产业集聚园区，规划建筑体量达100万平方米，首期15万平方米。该园区主要包括国产集成电路芯片设计、电脑硬盘、大数据磁盘阵列等三大产业，同时将重点引入国家、省市各级重点企业研究院、实验室及高校产学研中心。目前已经集聚了包括华澜微、博信智联、鼎龙控股、钜联半导体等一批相关产业龙头企业，成为集成电路设计相关产业总部及研

发基地，成功运营后年产值将突破百亿、税收突破十亿，有力支撑萧山数字经济的中
速发展，成为萧山新兴经济的又一增长极。



△杭州（萧山）集成电路重大项目签约仪式

同时，深圳市钜联半导体科技有限公司、上海宝嵩机器人有限公司以及湖北鼎龙控股
股份有限公司分别与萧山经济技术开发区管理委员会、杭州湾信息港高新建设开发有
限公司举办重大项目合作签字仪式。



△杭州市萧山区区委副书记、区长王敏致词

作为峰会主办方，杭州市萧山区区委副书记、区长王敏在致词中表示，萧山将以本次大会为契机，努力消化吸收峰会成果，依托“两廊两带”产业载体建设，加快信息安全、人工智能、工业互联网、集成电路设计等产业布局，加快建设集成电路设计产业园，并力争将萧山区建设成为科技要素集聚，研发创新活跃，创业氛围浓厚，生活服务完善，交通出行便捷，生态环境优美，产城创新度融合的创新强区。

专家齐聚、规模庞大，闪存峰会引行业风向

本次峰会精心设置了许多亮点环节

致力于打造成 2019 年度最有特色的闪存主题盛会

以及闪存和存储器产业的年度盛宴

华澜微 CEO、杭州电子科技大学教授、万人计划人才骆建军，浪潮存储产品线副总经理孙斌，谢华为智能数据与存储产品线全闪存领域产品总监黎明，英特尔中国区非易失性存储事业部总经理刘钢，戴尔科技集团大中华区现代化数据中心总经理毕经林，美国罗德岛大学教授、深圳大普微电子科技有限公司董事长杨庆，IBM 系统部存储技术总监刘淳，新华三存储产品总监张颖，Memblaze 产品副总裁张泰乐，阿里巴巴资深总监、阿里云存储负责人、达摩院数据库和存储实验室研究员吴结生，Pure Storage 亚太区技术总监何与晖，美国杜克大学电子与计算机工程系教授、IEEE Fellow 陈怡然，华为 SSD 产品管理和规划总监杨钊文，中国计算机学会信息存储专委会主任委员、华中科技大学计算机学院院长冯丹，威固副总裁、威固创新研究院院长李礼，上海宝存信息科技有限公司 Chief Engineer 苗宁忠，国科微首席固件架构师芮小丽等国内外近百位闪存、存储领域的重磅专家、学者从闪存技术、方案、实际应用等角度，围绕“闪存加速数字经济”这一命题探索闪存及存储现状与趋势，为全球闪存蓬勃产业注入源源不断的新动力。

大会同期还举行了闪存存储网络论坛、ABC 论坛、智能存储与存储新架构学术论坛专场、全闪存技术论坛、数字经济产业论坛等 12 场分论坛，近 70 场主题分享。来自闪存存储领域的女性代表，同台对话对存储产业洞察及职场心得，展现数字经济时代杰出女性的风采和“闪亮”故事。



在峰会期间，部分与会嘉宾还实地考察了坐落于萧山经济技术开发区的机器人小镇和信息港小镇，感受到了开发区航空、高铁、公路的便利交通与宜业、宜居、宜游的栖息环境，以及开发区以数字产业化、产业数字化、城市数字化发展的长远规划与建设思路。

2017年11月，杭州市发布了“集成电路产业发展规划”，确定萧山区重点发展集成电路封装及材料业，以整机应用和信息消费需求为牵引，推动整机与芯片联动、硬件与软件结合、产品与服务融合发展的自主创新产业生态建设。2019全球闪存峰会的举行、“杭州集成电路设计产业园”的启动及相关项目的签约，是萧山经济技术开发区落实这一规划的得力举措。



萧山，是浙江“大湾区”建设的重要平台，是杭州“拥江发展”的主阵地。萧山坐拥钱塘江 32 公里江岸线，有 1000 多平方公里的广阔腹地，能够承载最有前景的产业、最具活力的要素和最为宝贵的人才，是具有无穷想象和无限潜力的未来之城。萧山正在积极发挥这一得天独厚的优势，抢抓数字经济发展的新浪潮，实现以城聚产、以产兴城、产城融合的良好循环，打造大湾区的创新高地、数字硅谷！

（来源：数字经济智库）

中晶（嘉兴）半导体大硅片项目明年底试生产

近日，嘉兴召开百亿工业项目现场推进会，嘉兴经信部门的相关人员考察了南湖区中晶（嘉兴）半导体大硅片工地。

据中晶大硅片项目负责人介绍，目前该项目一期建设推进迅速，预计年底单体建筑完工，明年 6 月第一台设备进入，明年年底即可进行试生产。

今年年初，浙江嘉兴南湖区人民政府与上海康峰投资管理有限公司签署投资协议和定向基金协议，这也意味着年产 480 万片 300mm（12 英寸）大硅片项目将落户嘉兴科技城。

根据资料显示，该项目由上海康峰投资管理有限公司全资设立的中晶（嘉兴）半导体有限公司承担，国家企业信用信息公示系统显示，中晶（嘉兴）半导体有限公司已于 2018 年 12 月 12 日正式注册成立，注册资本 10 亿元，董事长亦为路仁军。

该项目选址嘉兴科技城产业加速与示范区，计划总投资 110 亿元，其中一期将投资 60 亿元，固定资产投资超 56 亿元，用地面积 139 亩，计划建设 300mm 单晶硅片生产线。该项目已成功入选 2019 年度浙江省第一批特别重大产业项目。

根据此前计划，该项目预计在 2021 年 2 月竣工投产，建成后规划年产能可达 480 万片 300mm 大硅片，预计实现年销售产值达 35 亿元。

（来源：全球半导体观察）

浙江省龙芯智慧产业园落地金华

近日，浙江省副省长高兴夫在杭州会见了龙芯中科技术有限公司总裁胡伟武及神州数码控股有限公司、清华同方股份有限公司负责人一行。会见结束后，金华市人民

政府与龙芯中科签署投资协议，金义都市新区管委会与龙芯中科、神州数码、清华同方签署项目落地协议，合力建设浙江省龙芯智慧产业园项目。

金华市领导陈龙、尹学群、郑余良、张伟亚，金华新兴产业集聚区党工委书记、管委会主任张新宇；省政府副秘书长董贵波及相关厅局负责人参加会见并见证签约。

高兴夫对龙芯中科等公司投资浙江表示欢迎。他介绍，近年来，浙江经济保持总体平稳，取得了高于全国、好于预期、领跑东部的好成绩。这得益于习近平总书记在浙江工作时提出的“八八战略”，也得益于狠抓传统产业改造提升，积极培育数字经济、生物经济、新材料等产业的扎实举措。但是，科技创新仍是浙江的突出短板。龙芯中科等公司是业内的领军企业，落地金华集聚发展，对补齐浙江科技短板、推动实体经济高质量发展、打造新一代人工智能创新发展高地等都具有十分重要的意义。他说，企业好，浙江就好。有关部门特别是金华市要以一流营商环境，全力以赴保障项目落地，快马加鞭抓好工作落实。

胡伟武介绍了公司发展情况及行业发展趋势。他表示，龙芯中科是目前国内少数能独立设计 CPU 并构建 IT 产业生态的企业。此次在金华投资，就是要抓住关键环节、重点领域，通过集聚发展，构建完整的技术体系和产业生态。公司将充分发挥技术支撑作用，吸引更多上下游关联企业来浙江投资兴业，推动创新发展。

据介绍，浙江省龙芯智慧产业园计划落地金华科技城，总用地面积 1300 亩，总投资 150 亿元以上，是义乌国际贸易综合改革试验区获批后，金义片区落户的又一重大产业项目。该项目将引进龙芯中科并依托其龙头地位，吸引关联上下游的芯片应用终端研发生产企业在金华集聚，打造千亿级浙中信息产业集群。昨天签约的清华同方，将设立计算机整机生产企业，投产后可实现年产值超百亿元；神州数码信息将投资建设覆盖浙江、面向华东的产业创新支撑平台；龙芯中科将以芯片研发设计制造为核心，打造信息技术和智能制造产业集群。目前，已有 4 家科研院所、51 家企业与龙芯智慧产业园初步达成合作意向。

（来源：金华日报）

.....

业界动态

深圳集成电路再看坪山，重磅 IC 基地落地

8月22日，“共建国家深圳 IC 基地坪山园和基地分平台”签约仪式在深圳举行。

国家集成电路设计深圳产业化基地坪山分园和基地分平台由坪山区科技创新局联合深圳 IC 基地、全国首家第三方商密产品检测机构（鼎铨商用密码测评技术（深圳）有限公司）共建，用以支持园内及全区 IC 企业孵化、产品研发和技术创新。

据悉，坪山分园主要依托坪山区创新广场园区、第三代半导体（集成电路）未来产业集聚区核心区和拓展区，以及国家新型工业化产业示范基地等高新区创新产业空间吸引集聚 IC 产业创新平台和项目。

目前，坪山区目前已集聚了 20 余家集成电路及第三代半导体核心企业，涵盖半导体的设计、制造、封装、测试等环节，拥有中芯国际、金泰克等企业并获批深圳首个 5G 网络试点区和智能网联汽车路测区。

在第三代半导体产业方面，北京顺义、深圳坪山的发展情况尤为突出。2018 年 10 月，坪山人民政府印发《坪山区关于促进集成电路第三代半导体产业发展的若干措施》（以下简称《措施》），进一步优化坪山区集成电路上下游产业布局。

具体来看，《措施》为当地第三代半导体产业发展提供了资金支持、空间保障、落户奖励、研发资助、产业协同、成本降低等优惠政策。

在资金支持方面，坪山区成立了产业发展专项资金、科技创新专项资金，并设立集成电路专项产业基金；融资资助方面，对企业获得一年期以上的信贷融资的，按利息或担保费的 50%，分别给予年度最高 200 万元资助；租金资助方面，对企业租赁创新型产业用房的，按市场评估价的 50%-90%给与资助；落户奖励方面，对新设立或新迁入的制造、封测类企业，按落户后第一年实际完成工业投资额的 10%给与最高 1000 万元的资助，对新设立或新迁入的设计、设备和材料类，按落户后第一年追加实缴资本的 10%给予最高 500 万元资助；在研发资助方面，对企业关键技术攻关的，按研发投入的 10%给予年度最高 500 万元资助，采取区域联合研发的资助额度最高 600 万元；在平台支持方面，对企业建设的公共服务平台，经区政府认定的，按设备购置费用的 50%一次性给予最高 2000 万元的资助。

在设计资助方面，企业购买 EDA 软件（含升级费用）、采购辖区公共服务平台设计服务、利用公共服务平台使用 EDA 软件、企业使用公共服务平台提供的 IP 复用服

务等按照实际发生费用的 50%，年度给予资助；在验证资助方面，对企业进行工程片、设备、材料测试验证的，按实际发生费用的 50% 给予年度最高 200 万元资助；在流片支持方面，对企业参加多项目晶圆（MPW）项目的，按 MPW 直接费用的 80%（高校或科研院所为 90%）给予年度最高 200 万元资助，对企业首次工程流片的，按实际费用的 30% 给予年度最高 300 万元，利用本辖区企业开展 MPW 的最高资助额度为 400 万元，利用本辖区生产线流片的，按实际费用的 60% 给予年度最高 600 万元资助；在首购奖励方面，对整机企业首购首用本辖区芯片，按采购金额的 10% 一次性给予最高 50 万元资助，对企业首购首用本辖区设备、材料的，按采购金额的 10% 一次性给予最高 100 万元资助；在经营资助方面，生产性用电支持：对生产企业，按用电费用 50% 给予年度最高 500 万元资助，环保处理支持：对企业的日常环保处理，按实际支出额的 50% 给予年度最高 100 万元资助，企业建设双回路、储能电站等用电设施的，按实际投入费用的 30% 一次性给予最高 500 万元资助，对企业建设环保处理工程的，按工程费用的 50% 给予年度最高 500 万元资助；在配套资助方面，对于承担军工科研项目、设立海外研发中心、建设公共服务平台、获国家首台（套）重大技术装备保险补偿的企业分别按上级资助额度的 1:1（前三项）、50% 给予配套资助。

（来源：南方都市报）

苏州高新区欲打造国家级集成电路公共服务平台

近日，苏州高新区举行 2019 集成电路产业技术研讨会暨重大项目启动签约仪式。来自全国的 200 名专家学者进行了 CIDM 半导体模式、IDM 与中国机会、集成电路工艺技术新发展等的专题研讨。会上，进行了共建 IC 芯未来“IP 共享社区”发布、“苏州微五科技有限公司”揭牌、苏州高新区集成电路产业可靠性分析与工艺验证公共服务平台建设启动等。

会上，江苏省产业技术研究院集成电路工艺研究所倡议，发起集成电路研发制造一体化的“IP 分享社区”。

由设计公司、制造企业、相关科研院所，共同建立集成电路设计及工艺 IP 库，为制造企业接入设计资源，为设计公司提供客户接口，创造集成电路研发制造一体化新模式，共建 IC 芯未来。

揭牌成立的苏州微五科技有限公司，由 RISC-V 产业化公司上海赛昉科技有限公

司与苏高新金控、苏州国芯科技等机构联合发起设立，总投资 1 亿元。项目基于上海赛昉在 RISC-V 开发上的成熟技术和苏州国芯在自主嵌入式 CPU 技术和芯片研发上的领先优势，主要开发应用于物联网领域的基于 RISC-V 架构的工业级单片微型计算机芯片。产品主要应用于物联网、汽车电子、智能工控、5G 智能计算以及存储、人工智能及信息安全等多领域。

启动建设的苏州高新区集成电路产业可靠性分析与工艺验证公共服务平台，一期投资约 1 亿元。该平台将开展高端集成电路破坏性物理分析、失效分析、可靠性分析、板级可靠性评价与验证等技术服务，实现面向智能制造、物联网、汽车电子、工业机器人端等新兴产业对集成电路可靠性评价的要求，支撑国产集成电路及相关产业的质量可靠性提升与健康持续发展。该平台预计 2020 年 6 月可形成服务能力，建成后将配备国际最先进的可靠性评价与验证仪器设备，形成一支特色鲜明、技术过硬、具有行业影响力的“国家级”技术开发服务队伍，为长三角乃至全国的集成电路企业提供快速、先进的评价与验证、技术咨询和人才培养等专业技术服务。

近年来，苏州高新区制定了集成电路产业发展规划，集聚了长光华芯、国芯科技、中晟宏芯、硅谷数模等一批领军型企业；拥有中移动苏州研发中心、阿里云、中兴克拉等一大批应用企业，构筑了丰富的应用场景。2018 年，苏州高新区新一代信息技术产业总产值近千亿元，到 2020 年力争超 1500 亿元，成为长三角地区龙头。

（来源：苏州日报）

北京顺义出台支持政策 促进第三代半导体产业聚集

8 月 24 日，中关村第三代半导体产业政策发布会召开。据悉，为促进第三代半导体等产业在中关村顺义园聚集发展，中关村和顺义区将在企业研发创新、成果转化和产业化等方面提供资金支持。其中，中关村管委会上限支持额度为 5000 万元，而顺义区的支持额度不设上限。

今天，中关村科技园区、顺义区人民政府联合制定的《关于促进中关村顺义园第三代半导体等前沿半导体产业创新发展的若干措施》（以下简称“《若干措施》”）正式发布。据中关村管理委员会党主任翟立新介绍，第三代半导体产业发展水平是一个国家现代经济与高科技力量的重要象征，也是当前世界各国科技竞争的焦点之一。但是，第三代半导体产业的发展需要高强度、持续资金投入，且经济见效慢，这就要求地方政府要能够把握产业发展规律，给予支持。出台《若干措施》的目的就是促进第三代半导体等前沿半导体产业在中关村顺义园聚集发展。

《若干措施》的资金支持范围覆盖全产业链。例如，针对企业开展新型半导体器件的设计和研发，对上一年度实际发生费用，按照不超过 30%的比例，给予最高不超过 2000 万元的资金支持；在成果转化环节，对上一年度开展特定零部件采购、原材料和设备购置等实际支出，也按照不超过 30%的比例，给予最高不超过 2000 万元的资金支持。

此外，《若干措施》围绕第三代半导体等前沿半导体产业的突出需求，解决企业在研发、生产、公共设施配套、市场推广等环节的关键问题。比如，支持海外顶尖科技人员或国内院士研发团队在中关村顺义园建立研发机构和院士专家工作站，每年给予最高不超过 1000 万元的资金支持，并为高科技人才安排配套公租房，提供住房补贴。

（来源：新京报）

武汉：集聚百余家芯片企业，筹划 10 亿元光谷集成电路产业基金

8 月 21 日，湖北省委宣传部召开庆祝新中国成立 70 周年系列新闻发布会第五场。

会上透露，未来，面对建设国家存储器基地、打造“一芯驱动”引擎的新使命，武汉东湖高新区正在谋划完善顶层设计，其中就包括筹划光谷集成电路产业基金，规模 10 亿元。

在此次新闻发布会上也介绍了当前武汉正在争创综合性国家产业创新中心，同时已经编制了《武汉市综合性国家产业创新中心建设方案》，将加快存储器、航天产业、网络安全人才与创新、新能源和智能网联汽车以及大健康产业五大基地建设，着力打造光电子信息、汽车及零部件、生物医药及器械三大万亿产业集群，装备制造、能源环保、健康食品若干个千亿产业，以及一批百亿企业，构建高质量发展的产业体系。

当前，武汉正在打造“芯屏端网”万亿产业集群。

武汉发布显示，武汉市已集聚芯片企业 100 余家，正在形成国家级“芯”产业高地，武汉集成电路设计产业增速位居全国前三（位居香港、杭州之后）；武汉光纤光缆生产规模全球第一，占国内市场的 2/3、国际市场的 1/4；光电器件、光传输设备国内市场占有率分别为 60%、10%。目前正在布局互联网+、5G 通信、网络安全产品和服务等下一代信息网络产业集群。

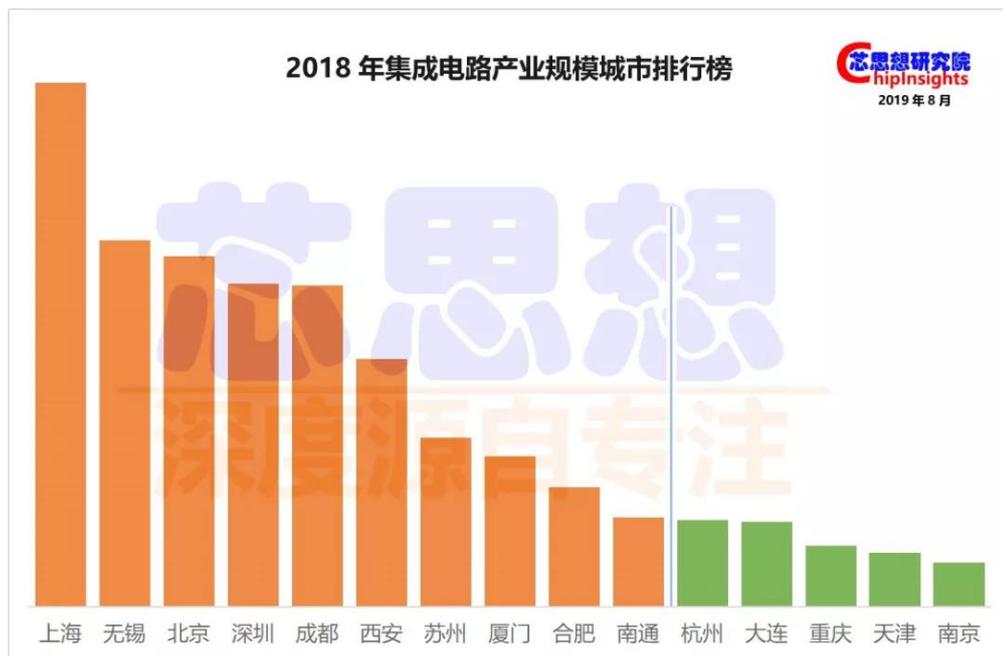
此外，武汉还策划布局了存储器、航天、网络安全人才与创新、新能源和智能网

联汽车 4 个国家级产业基地，加快构建高新技术产业迭代发展的生态矩阵，据不完全统计，已吸引投资 5000 亿元。

（来源：武汉发布）

芯思想研究院推出第一版中国集成电路产业规模城市排名榜

芯思想研究院（ChipInsights）经过调研，特推出第一版中国集成电路产业规模城市排行榜。第一版中国集成电路产业规模城市排行榜以百亿为基础排列。



芯思想研究院第一版百亿中国集成电路产业规模城市排行榜上榜城市有 15 个。其中长三角有 7 个城市上榜，江苏占有四席，分别是无锡、苏州、南通、南京，另外有上海、合肥、杭州；环渤海地区有北京、大连、天津三城入围；珠三角地区有深圳、厦门入围；中西部地区有成都、西安、重庆入围。

前十大城市中，长三角占据一半，五席分别是上海、无锡、苏州、合肥、南通；环渤海只有北京一个入围；珠三角和中西部各有两席。

过百亿的 15 个城市集成电路产业规模合计为 8280 亿元，前 10 大城市集成电路产业规模合计为 7370 亿元，占比 89%。

2018 年无锡成为继上海之后，第二个产业规模超过 1000 亿的城市。

一、上海

据上海集成电路行业协会的数据，2018 年上海集成电路产业规模达 1450 亿，较 2017 年实现 23% 的增长，位居全国各城市之首。

上海市提出推动集成电路全产业链自主创新发展，提升产业规模和能级，打造具有国际影响力的软件和集成电路产业集群和创新源，规划到 2020 年集成电路产业规模为 2000 亿元。根

上海在设计领域，部分企业研发能力已达 7 纳米，紫光展锐手机基带芯片市场份额位居世界第三。在制造领域，中芯国际、华虹集团年销售额在国内位居前两位，28 纳米先进工艺已量产，14 纳米工艺研发基本完成。在装备材料领域，中微、上微处于国内领先水平。

上海集成电路产业投资基金总额 500 亿元，分为 100 亿元的装备材料基金、100 亿元的设计基金、300 亿元的制造基金。基金将加快促进汽车芯片、智能移动芯片、物联网芯片、AI 储存器芯片、安全芯片以及智能储存器芯片等高端芯片的研发和生产。

二、无锡

根据江苏省半导体行业协会的最新数据来看，无锡市在 2018 年集成电路产业规模达 1014 亿元，较 2017 年实现 14% 的增长。

无锡市当属江苏省集成电路产业发展水平最高的城市，无锡市原计划到 2019 年集成电路产业规模达 1000 亿元，提前一年超额完成任务，无疑已是国内集成电路产业第一方阵行列。

无锡作为“国家南方微电子工业基地中心”，近年来一直在构造集成电路“芯”版图，经年积累形成了较为完备的产业链，集聚了包括华虹半导体、华润微电子、长电科技、中科芯、中德电子（江阴润玛）、江化微、东晨电子、固电半导体、宜兴中环领先等在内的 200 多家企业，涵盖集成电路设计、制造、封装测试、装备与材料等多个领域，集成电路的全产业链发展格局在锡渐成，勾勒出了无锡集成电路的美丽风景。

2000 年以来，先后成为国家科技部批准的 8 个国家集成电路设计产业化基地之一、全国仅有的两个由国家发改委认定的国家微电子高新技术产业基地之一（另一家是上海）。

2016 年，以“产业强市”战略为引领，无锡市出台《加快集成电路产业发展的政策意见》。2017 年 2 月，《关于进一步支持集成电路产业发展的政策意见》发布，设立总规模 200 亿元的产业投资基金。《意见》立足实际，秉承设计优先原则，扩大覆盖面，加大扶持力度，整合产业链上下游，助力无锡集成电路产业集群做大做强。

目前无锡已经调整发展目标，计划到 2020 年底集成电路产业规模达 1200 亿元。相信随着华虹半导体无锡基地 12 英寸生产线和宜兴中环领先大硅片项目的顺利投产，1200 亿的产业规模目标应该非常轻松达成。

不过无锡 IC 设计业偏弱，占比仅为 10%；制造业占比 25%；封测业占比高达 40%，设备材料占比 25%。

三、北京

2018 年集成电路产业规模达 970 亿，较 2017 年实现 8% 的增长；排名仅仅次于上海和无锡，位居全国第三。

北京市规划到 2020 年建成设具有国际影响力的集成电路产业技术创新基地。经过多年发展，北京形成了“北（海淀）设计，南（亦庄）制造”的集成电路产业空间布局，积累了一定的“家底儿”。以中芯北方、北方华创、屹唐半导体、集创北方为代表的一批产业链上下游企业，正紧密合作，协同打造北京集成电路产业的“芯”实力。

四、深圳

深圳市 2018 年集成电路产业规模为 890 亿，较 2017 年实现 34% 的增长。

深圳市的集成电路产业规模位列珠三角地区首位，规划到 2023 年建成具有国际竞争力的集成电路产业集群。

深圳作为国内集成电路产业重要聚集区，长期处于设计业龙头位置，在晶圆制造、封装测试领域非常薄弱。根据深圳新的产业规划，当地将补齐芯片制造业和先进封测业产业链缺失环节，聚焦提升芯片设计业能级和技术水平，注重前瞻布局第三代半导体，努力优化产业生态系统，加快关键核心技术攻关，培育龙头骨干企业和集成电路产业集群。

五、成都

2018 年成都集成电路产业规模较 2017 年实现 23% 增长。

成都市要跻身国内集成电路设计第一方阵，打造中国“芯”高地，规划到 2035 年集成电路产业规模 3400 亿元。这个规划周期确实有点远。

成都的集成电路产业主要集聚在高新区。在芯片设计方面，拥有各类设计公司 120 多家，包括振芯科技、锐成芯微、和芯微、雷电微力、华大九天、华为海思、新华三等各具特色的企业，设计领域涵盖网络通讯、智能家电、物联网、北斗导航、IP 等；在晶圆制造方面，拥有德州仪器 8 英寸晶圆生产线；在半导体封测方面，成都拥有华

天科技（原宇芯）、士兰微、英特尔、德州仪器、芯源系统（MPS）等近十家封装测试企业，形成西南最大的芯片封装测试基地。

六、西安

2018年西安集成电路产业规模较2017年实现5%增长。

西安市打造集成电路产业新高地，规划在2021年集成电路产业规模达1000亿元。西安依靠三星电子存储芯片项目和华天科技西安、美光/力成封装项目，大大增强了西安在集成电路产业中的竞争力。

目前西安形成了从半导体设备和材料的研制与生产，到集成电路设计、制造、封装测试及系统应用的较完整产业链。

从整个产业链的发展情况来看，西安集成电路产业已经形成制造业一枝独秀，设计业与封装测试业相互依存、协调发展的产业格局。

七、苏州

2018年苏州集成电路产业规模较2017年实现7%增长。

苏州在集成电路封装测试、集成电路设计、第三代半导体材料等方面保持国内领先，拥有中科院苏州纳米所等为代表的一大批科研院所和龙头企业，随着中科曙光、澜起科技等一批旗舰项目落户，集聚效应已初步形成。目前，苏州市在芯片最有价值的设计领域，已积累了一批实力企业。当前，苏州市重点支持工业园区和昆山等地区发展集成电路封装和测试产业。园区是国内集成电路产业最集中、企业最密集的地区之一，目前已集聚集成电路设计企业40多家。

八、厦门

2018年厦门集成电路产业规模突破400亿关口。

厦门市是国家集成电路布局规划重点城市，致力构建集成电路全产业链，规划到2025年集成电路产业将达1500亿元。厦门已经形成火炬高新区、海沧区、自贸试验区湖里片区三个集成电路集聚区，目前成功引进了一大批龙头项目，初步覆盖集成电路设计、制造、封测、装备与材料以及应用等产业链环节，聚集了三安光电、联芯集成、士兰微、通富微电、紫光展锐、瀚天天成、美日丰创等200多家集成电路企业，部分环节的生产力达到国际一流水平。

九、合肥

2018年合肥市集成电路产业规模较2017年实现25%的增长。在长鑫量产后，预计2019年合肥集成电路产业规模会有较大增长。

合肥市打造中国 IC 之都，被列为全国九大集成电路集聚发展基地之一，计划到 2020 年集成电路产业规模达 500 亿，其中设计业 100 亿，制造业 300 亿，封测 60 亿，设备材料 40 亿。随着晶合集成、长鑫集成的投产以及强势引进的一批设计、材料企业，加上宏实自动化、易芯半导体、大华半导体、芯碁微电子等一批本土企业，合肥已逐步形成了集成电路设计、制造、封测、设备材料等全产业链，并带动其他高科技产业取得了良好的发展态势。

在产业布局上，合肥市现已形成了三大集成电路产业基地——经开区、高新区、新站高新区。2018 年 9 月 27 日合肥市正式被授牌成为“海峡两岸集成电路产业合作试验区”，合作试验区包括合肥市三大集成电路产业基地——经开区、高新区、新站高新区。

十、南通

2018 年南通集成电路产业规模较 2017 年实现 23% 增长。

近几年南通集成电路产业飞速发展，已初步形成完整产业体系。汇聚了包括通富微电、越亚半导体、京芯光电、捷捷微电子、启微半导体在内的一批企业。

十一、杭州

杭州市致力打造集成电路设计创新之都，从杭州市人民政府印发的《杭州市集成电路产业发展规划》可以看出，到 2020 年年底，全市集成电路产业主营业务收入力争达到 500 亿元；明确提出集成电路设计业是杭州信息经济创新发展的长期有效的驱动力，重点发展集成电路设计产业，提升全市整机系统企业的核心竞争力。杭州市的行动目标重点发展芯片设计，选择特色芯片、高端存储芯片等芯片的制造，兼顾封装测试与材料的较为完整的集成电路产业链。

杭州是八个国家集成电路产业设计基地之一，经过多年发展，在集成电路设计领域已经取得了一些优势，汇聚了包括中天微系统、广立微电子、士兰微在内的一批优质公司。目前拥有多个细分领域精尖核心技术，在嵌入式 CPU、EDA 工具、微波毫米波射频集成电路、数字音视频、数字电视、固态存储（固态硬盘控制器）、计算机接口控制器（包括磁盘阵列和桥接芯片）、LED 芯片和光电集成电路等领域技术水平处于国内领先地位，个别甚至处于国际先进水平，进入了国际主流市场。

十二、大连

2018 年大连市集成电路产业规模较 2017 年实现 60% 增长，其中英特尔大连就高达 227 亿。

大连市要打造世界级集成电路产业基地，计划到 2025 年集成电路产业规模达 500 亿。2108 年随着英特尔大连工厂二期扩建项目投产，有力助推大连市集成电路产业发展水平迈向新的高度。

十三、重庆

重庆市规划到 2022 年力争成为中国集成电路创新高地，集成电路产业规模达 1000 亿。重庆一直是我国重要的电子信息产业基地，但电子信息产业需要高水平集成电路技术支撑产业发展。重庆将着力培育高端功率半导体芯片项目，重点解决制约集成电路产业发展的技术问题和创新生态问题，实现重庆产芯片产品全面支撑重庆市智能终端、物联网、汽车电子、智能制造、仪器仪表、5G 通信等电子信息领域应用需求。

重庆的集成电路产业主要集中在西永微电子产业园区，园区已构建从 EDA 平台、共享 IP 库、芯片设计、制造到封装测试的集成电路全新产业生态，吸引了华润微电子、SK 海力士、中国电科、西南集成等一批知名集成电路企业聚集发展。目前正全力打造全球协同研发创新平台 UMEC 联合微电子中心、全国最大功率半导体基地和韩国 SK 海力士集团全球最大的芯片封装测试工厂。

十四、天津

2018 年，由于统计口径的不同，天津集成电路产业规模较 2017 年有 20% 的下滑。

天津市致力建成具有国际竞争力的集成电路产业集群，计划到 2020 年集成电路产业规模达到 600 亿元。2018 年出台的《天津市关于加快推进智能科技产业发展若干政策》中明确指出支持集成电路产业发展，从支持集成电路设计企业发展与支持集成电路产业重点项目建设两个方面发力。并设立了中芯海河赛达产业投资基金、海河产业基金、智能科技产业母基金等多支投资基金。

天津集成电路产业逐步形成了 IC 设计、芯片制造、封装测试三业并举、新型半导体材料与高端设备支撑配套业共同发展的相对完整的产业链格局，聚拢了集成电路企业百余家，聚集了紫光展锐、唯捷创芯、国芯等一批国内集成电路设计龙头企业；芯片制造业拥有中芯国际、中环股份、诺思科技等知名企业；封装测试业有恩智浦半导体、金海通、双竞科技等重点企业；材料与设备支撑业聚集了中环半导体、中电 46 所、华海清科等企业。

十五、南京

2018 年，南京集成电路产业规模实现了 56% 的增长，一举突破 100 亿大关。。

南京市打造集成电路产业地标。从南京市经信委发布的《关于打造集成电路产业地标的实施方案》中可以获悉，到 2025 年，全市集成电路产业综合销售收入力争达到 1500 亿元，进入国内第一方阵，在 5G 通信及射频芯片、先进晶圆制造、物联网和汽车电子等高端芯片设计等细分领域实现全省第一、全国前三、国际知名。为此南京市明确提出了将设立总规模 200 亿美元的南京市集成电路产业投资基金，支持集成电路产业垂直整合及并购重组，加大高端人才引进培育力度等。

南京的集成电路产业主要聚集在江北新区，目前已经拥有台积电、华天科技、长晶科技等一批行业龙头，集聚了 260 余家集成电路产业企业，覆盖行业内芯片设计、晶圆制造、封装测试、终端制造等全产业链环节。

（来源：芯思想）

合肥兑换集成电路产业红包，年销售首次破百亿奖励五百万元

据合肥市人民政府发布报道，近日，合肥市发改委组织开展 2019 年度合肥市集成电路产业发展若干政策相关事项申报工作，从事集成电路产业研发、生产和服务的企业符合条件，就能拿到财政资金“大礼包”。

根据申报内容，合肥将对经认定的年度销售收入首次突破 5000 万元、1 亿元、5 亿元、10 亿元、20 亿元的集成电路设计企业，分别给予企业管理团队最高不超过 50 万元、100 万元、150 万元、200 万元、300 万元的一次性奖励，每上一个台阶奖励一次。

对经认定的年度销售收入首次突破 5 亿元、10 亿元、50 亿元、100 亿元的集成电路制造、封装测试、装备及材料类企业，分别给予企业管理团队最高不超过 50 万元、100 万元、200 万元、500 万元的一次性奖励。

对经审核认定的企业首次采购本市企业自主开发的集成电路芯片；或经审核认定的企业首次采购能够形成本市产业链协同发展或服务其他产品的，给予补贴支持。

对首次采购自主开发的集成电路芯片的企业，按照年采购金额的 20% 给予补贴，最高不超过 300 万元。对首次采购能够形成产业链协同发展或服务其他产品的企业，按照年采购金额的 10% 给予补贴，最高不超过 500 万元。

此外，合肥还将支持企业共建技术服务平台和产业促进平台。经认定符合条件的，对年度服务集成电路企业超过 20 家的平台，给予不超过建设投资额 30%，最高不超过

200 万元的一次性资金支持。对经认定的集成电路领域服务平台按照上一自然年度服务收入 30%给予支持，最高不超过 300 万元，补贴不超过 3 年。

在人才建设方面，合肥将支持集成电路企业建立人才实训基地和引进集聚产业紧缺人才。经区级以上人社部门认定的具有高校毕业生就业见习基地的企业，或与国内本科高校院所已签订合作开展实训协议的企业，上一自然年度开展集成电路领域免费实践培训活动，学生在实训基地连续实践超过 3 个月。经认定，按照 500 元/人（免费培训人员）标准给予企业补贴，单个企业每年最高不超过 50 万元。

（来源：合肥市人民政府）

集成电路、生命健康产业增长迅猛 南京江北新区崛起两大千亿级产业集群

位于江北新区研创园的紫光展锐南京研发中心内，前沿的 5G 通信产品正在研发；浦口开发区内，全球最大集成电路制造服务企业台积电马力全开；生物医药谷企业健友生化研发的依诺肝素钠注射液，被英国药监机构许可上市，已具备在欧盟市场销售的资格……

上半年，江北新区集成电路产业主营业务同比增速达 122%，生命健康产业主营业务收入同比增长 47%。产业跑道上，“芯片之城”与“基因之城”并驾齐驱，带动江北新区新兴产业一路疾驰。预计今年，新区生命健康产业将达到千亿元规模，集成电路产业将在 2020 年达到千亿级规模，成为推动新区高质量发展的强劲动力。

龙头引领，优化产业链布局

去年，江北新区集成电路产业主营业务收入同比增长超 30%，今年上半年，这一数据刷新为 122%。

新区紧扣龙头优势，除了台积电、紫光南京半导体产业基地，富士康旗下的京鼎精密南京半导体产业基地也紧跟而来。在这些“领跑员”的驱动下，新区“芯片之城”建设全面提速。

如今，全球最大芯片设计自动化企业 Synopsys、世界知名集成电路设计公司 ARM 等纷纷落户新区，国内排名前十的集成电路设计企业已有一半在新区落户，带动集聚上下游企业 260 多家，其中去年新增集成电路设计企业 50 余家，龙头企业带动并见证了新区集成电路产业资源厚度的积淀。

在生命健康领域，拥有全亚洲最大基因测序平台的国家健康医疗大数据中心，成为带动产业集聚的另一大龙头。中心内，世界最先进的二代测序仪 NovaSeq6000 可在 40 个小时内生成基因序列信息，存储分析服务器和超级计算机，运算能力在健康行业领域排名第一。

正是看中了大数据中心的顶级硬件优势，众多企业慕名而来。目前，新区已集聚生命健康相关企业 700 余家，构成了以研发创新为主的生命健康产业结构，集聚先声东元、绿叶制药、健友生化、药石科技、世和基因、医渡云等一批产业龙头创新企业，产业集群效应逐步显现。2018 年，新区生命健康产业主营业务收入突破 500 亿元。

瞄准高精尖，攻克核心技术

5G 是近期的一大热门话题。随着我国 5G 商用牌照正式发放，5G 运用也真正被提上日程，逐步从实验室走入日常生活。

国内最大芯片设计公司之一的紫光展锐对位于江北新区的南京研发中心委以重任，将其 5G 通信产品的研发放在这里。去年该公司推出的 5G 原型机以及下一步推出的 5G 手机芯片，当中一些重要的设计部分都由南京团队完成。

与 5G 技术跻身世界“第一梯队”不同的是，我国集成电路产业总体仍处于发展初期。目前，自动驾驶的关键设备激光雷达主要依靠进口，成本每件高达 2 万美元，而在新区，一家初创企业将这一成本降至几百美元。南京芯视界微电子科技有限公司副总经理左赋斌说：“我们研发的激光雷达核心芯片，可用于扫地机器人、自动驾驶甚至是智能手机，给这些设备都加上三维视角。”

左手芯片，右手基因，一个是机器运行的“大脑”，另一个是维持生命健康的“心脏”。“基因之城”围绕基因检测、精准医疗、创新药物研发等重点方向，加快医疗创新要素集聚。

今年年初，南京市首家科创板 IPO 企业南微医学参与的“内镜超声微创诊疗体系的建立与临床应用”项目，获得国家科技进步二等奖。3 月，药企健友生化研发的依诺肝素钠注射液，收到英国药监机构签发的上市许可，标志着该药已具备在欧盟市场的销售资格。这一注射液主要功效为抗凝、抗血栓，用于预防血栓形成或治疗栓塞性疾病。

全要素布局，打造现代产业体系

前不久，江北新区在南京创新周专场活动中发布集成电路人才试验区政策，以国内空前的力度吸引产业人才。政策覆盖了人才引进、留才奖励、人才培养和生活配套

四大方面，同时，设立 50 亿元的集成电路产业专项基金和 IC 设计专项奖励，企业首次达到一定规模给予核心团队最高 1000 万元奖励。

集成电路与生命健康同属人才、资本密集型产业，二者缺一不可。2018 年，约有 7 万名大学生在江北新区就业，吸引海外归国人员 2727 人、外籍常驻专家 2093 人，均位居我市首位。从就业质量来看，2018 年专业技术人员占比达到 40.84%，科技活动人员平均占比约 33.19%，新区日益成为人口、资金与技术的高度集聚地和高速增长区。

新区在产教融合上频出新招，有针对性地推动校企合作。集成电路方面，已联合东南大学、南京大学等 7 所著名高校建立了国家示范性微电子学院（南京）人才培养联盟；生命健康方面，新区统筹重大新药创制的区域布局，以成立新型研发机构为契机，与北京大学、南京大学等高校院所合作共建，已诞生 20 家与生命健康产业相关的新型研发机构。

围绕“两城一中心”战略发展，新区还设立了江北新区发展基金，形成 200 亿元总规模的“基金群”，初步构筑“芯片”“基因”两大主导产业的资源网络，为产业发展注入源源活水。

（来源：南京日报）

.....

通知公告

1、转发浙江省科学技术厅国家税务总局浙江省税务局关于印发《进一步落实税收优惠政策服务科技创新发展的若干措施》的通知

http://kjt.zj.gov.cn/news/node01/detail0101/2019/0101_87452.htm

1、转发滨江区关于开展杭州市 2019 年“百千万”高技能领军人才遴选工作的通知

http://www.hhtz.gov.cn/art/2019/8/13/art_1487002_36891243.html

编辑部：杭州市滨江区六和路 368 号海创基地北楼四楼 B4088 室

杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司

邮政编码：310053

E-mail: incub@hicc.org.cn

电 话：86- 571- 86726360

传 真：86- 571- 86726367